



HoLR1206 封体合金系列规格书

系列号	HoLR
修订日期	2019-04-19
版本号	Ho-A0

规格书 Specification



制造商:深圳市毫欧电子有限公司

HoLR1206

适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoLR1206-75ppm 系列产品选型。

产品特点 Features:

- 合金芯片，封体工艺，焊接性能良好
- 高可靠性，高过载能力，产品精度高。
- 使用温度范围较宽无感型设计
- 电阻温度系数 $TCR \times 10^{-6}/^{\circ}C \leq 75ppm$
- 符合 ROHS 要求和无卤要求

产品名称 Product Name

封体合金电阻

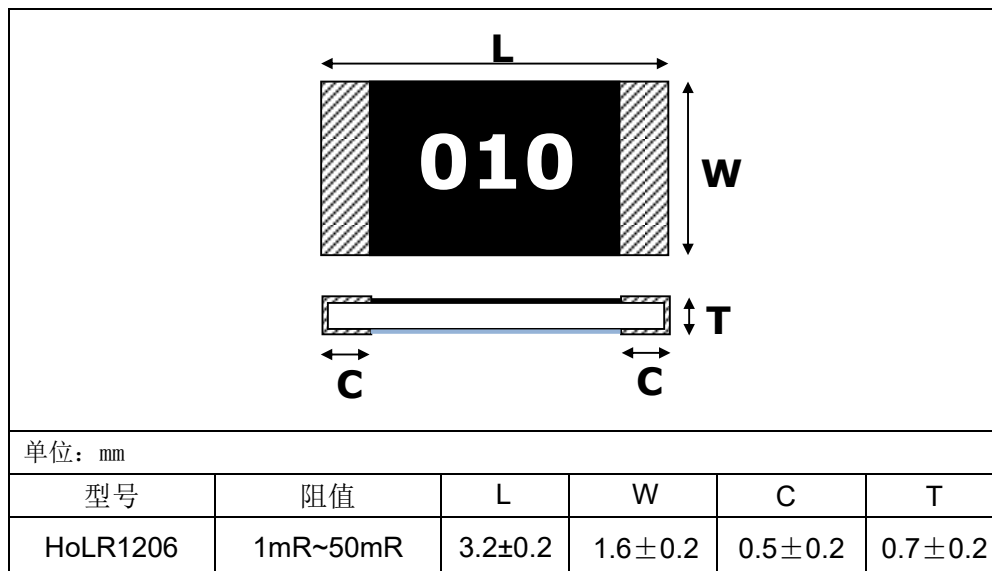
产品型号 Product number

Ho	LR	1206	1W	5mR	1%	75ppm
制造商	产品系列	封装	额定功率(W)	阻值(mR)	精度(%)	温度系数 TCR (ppm)
Ho 毫欧电子	LR 合金	1206	1	1~50	±1 ±5	≤75



地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 产品尺寸 Product Size

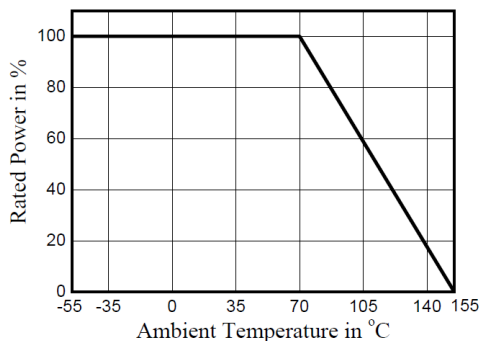


■ 电气参数 Electrical parameter

额定功率 Rated power	1W
阻值范围 Resistance range	1mR~50mR
最大额定电流 Max.Rated Current	31.62A
准确度等级 AccuracyClass	1%、2%、5%
电阻温度系数 T.C.R (ppm / °C)	≤75
工作温度范围 Operating Temperature Range	-55°C~+155°C

■ 功率曲线 Power curve

操作温度范围 - 55 ~ +155 °C 电阻温度达到 100 °C 时降功率示意图



地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu

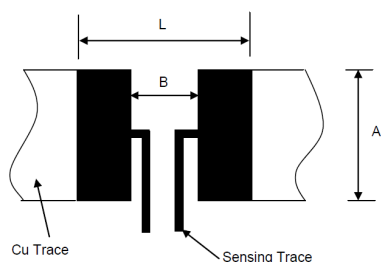
I :Rated Current (A)

P:Rated Power (W)

R:Resistance Value (Ω)

$$I = \sqrt{P/R}$$

■ 建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension

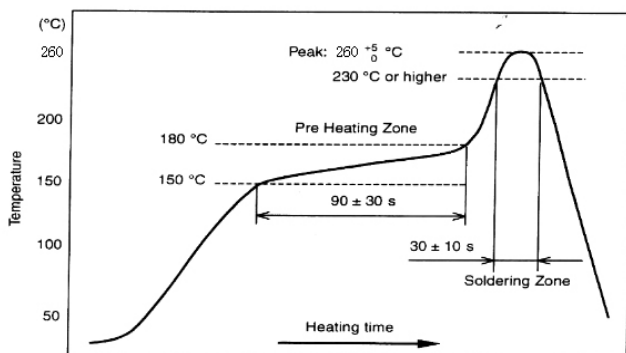


单位: mm

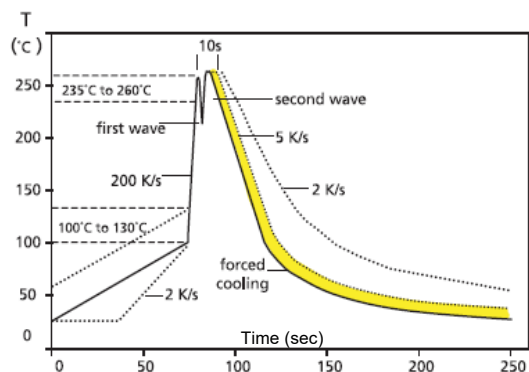
阻值	A	L	B
1mR~10mR	1.8	4.7	1.2
11mR~20mR			1.8
21mR~50mR			2.2

■ 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters

预热: 150 to 180 °C, 90 ± 30秒, 焊接区: 230 °C 或更高, 30 ± 10 秒
峰值: 260 ± 5 °C, 5秒.

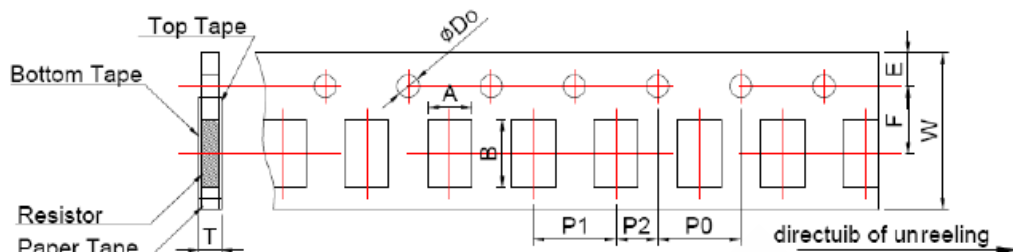


回流焊曲线图



波峰焊曲线图

地址: 深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

■ 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm)


A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
2.0±0.2	3.6±0.2	8±0.2	3.5±0.05	1.75±0.1	4.0±0.1	2±0.05	4±0.05	Φ 1.55±0.1	1.05±0.15

■ 可靠性测试 Reliability Tests

Test Items	Reference standard	Condition of Test	Test Limits
Temperature Coefficient of Resistance	IEC60115-1-4.8 JIS-C5201-4.8	+25°C ~ +125°C	Refer 4.0
Load Life	IEC60115-1-4.25.1 JIS-C5201-4.25.1	1000hours at rated power, 70°C, 1.5hours "ON", 0.5hour "OFF"	< ±1%
Short Time Overload	IEC60115-1-4.13 JIS-C5201-4.13	5 X rated power for 5s	< ±1%
Moisture no Load	IEC60115-1- 4.24.2.1a) JIS-C5201- 4.24.2.1a)	85°C, 85%RH, 1000hrs	< ±1%
Temperature cycle	IEC60115-1-4.19 JIS-C5201-4.19	-55°C & +155°C, 100cycle, 15min per extreme condition	< ±1%
Resistance to Soldering Heat	IEC60115-1-4.18 JIS-C5201-4.18	260±5°C for 10±1 sec	< ±0.5%
Solderability	IEC60115-1-4.17 JIS-C5201-4.17	245±5°C, 2±0.5sec	At least 95% of surface area of electrode shall be covered with new solder
High Temperature Exposure	IEC60115-1- 4.23.2 JIS-C5201-4.23.2	155°C, 1000hrs	< ±1%
Low Temperature Storage	IEC60115-1- 4.23.4 JIS-C5201-4.23.4	-55°C, 1000hrs	<±1%
Substrate Bending	IEC60115-1-4.33 JIS-C5201-4.33	Bending width 2mm	< ±0.5%
Insulation Resistance	IEC60115-1-4.6 JIS-C5201-4.6	100V DC for 1 minute	>100 MΩ

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼

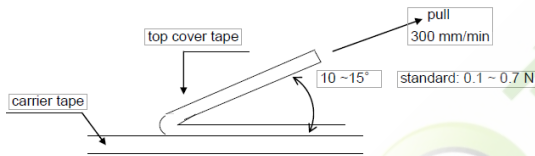
系列号	HoLR
修订日期	2019-04-19
版本号	Ho-A0

■ 卷轴规格 Reel Specification


Φ A	Φ B	Φ C	W	T
180+0/-3	60±1	13±1	9±1	11.4±1

■ 顶盖胶带的剥离强度 Peeling Strength of Top Cover

试验条件：剥离速度为 300mm / min 时为 0.1~0.7N



储藏条件：温度：5℃~35℃，湿度：40%~75%

■ 包装方式 Packing

编带盘装：5000PCS/盘

地址：深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼